LOPEC
2.-4. März 2027 | Messe München
Lopec.com

Pressemitteilung | 09.11.2026

LOPEC 2027 bringt Forschung und Fertigung zusammen

- **Wachsende Ausstellung**
- **Konferenz fokussiert industrielle Skalierung**
- **Anwender-Sessions mit neuem Zuschnitt**

Flexible und gedruckte Elektronik erschließt weitere Einsatzfelder: Neben Automobilindustrie, Gesundheitswesen und Verpackungen rücken auch vermehrt Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt in den Blick. Diese Entwicklung beschreibt die OE-A in ihrer aktuellen Roadmap. Mit der wachsenden Zahl möglicher Anwendungen gewinnt eine Frage an Gewicht: Wie lässt sich die Technologie skalieren, damit diese reproduzierbar, schnell, zuverlässig und wirtschaftlich ist?

Hier setzt die LOPEC 2027 im ICM – International Congress Center Messe München an. Die Konferenz findet vom 2. bis 4. März statt, die Fachmesse am 3. und 4. März. Die LOPEC bringt dort Hersteller, Materialanbieter, Maschinenbauer, Forschungseinrichtungen und Anwender zusammen. Gleichzeitig bietet sie einen Überblick über Technologien und Anwendungen und verbindet diesen mit dem fachlichen Austausch über ihre industrielle Umsetzung.

Flächenplus durch internationale Nachfrage
Die Anmeldesituation ist vielversprechend: Die gebuchte Ausstellungsfläche liegt derzeit leicht über dem Stand zum vergleichbaren Zeitpunkt des Vorjahres. Besonders erfreulich ist die starke internationale Nachfrage. Die Buchungen ausländischer Unternehmen liegen deutlich über dem Vorjahr.

Sabine Wagner
PR Manager
Tel. +49 89 949-20802
sabine.wagner@messe-muechen.de

OE-A Pressekontakt:
Isabella Treser
Head of
Communications OE-A
Tel. +49 69 6603 1896
isabellla.treser@oe-a.org

Messe München GmbH
Am Messesee 2
81829 München
Deutschland

„Wir freuen uns über den positiven Zwischenstand und die starke Nachfrage aus dem Ausland. Zugleich sehen wir bei den Abstract-Einreichungen im Rahmen der LOPEC Konferenz großes Interesse am Thema Skalierung im weitesten Sinn. Gedruckte Elektronik wird industriell eingesetzt. Jetzt geht es darum, weitere Anwendungen wirtschaftlich in die Serie zu bringen. Dafür müssen Materialien, Prozesse und Systemintegration zusammenpassen. Auf der LOPEC kommen die entsprechenden Partner direkt zusammen“, sagt Armin Wittmann, Exhibition Director der LOPEC.

Skalierung für die Serienfertigung

Wie stark das Thema Skalierung Forschung und Industrie beschäftigt, zeigt bereits ein Blick auf die eingereichten Abstracts. In der Technical Conference entfallen die meisten Einreichungen auf den Bereich „Upscaling Production and Manufacturing“, in der Scientific Conference steht „Scalable, Sustainable, Innovative Processes“ im Mittelpunkt. Ein klares Zeichen dafür, dass die Branche sich mit der industriellen Fertigung in großen Stückzahlen beschäftigt. Daran knüpft auch die Podiumsdiskussion an. Ein hochkarätig besetztes internationales Panel aus Industrievertretern diskutiert, was es braucht, um gedruckte Elektronik erfolgreich zu skalieren. Dabei geht es um drei entscheidende Faktoren: die Reife der Geschäftsmodelle, die Fertigungsreife und den technologischen Reifegrad. Denn erst wenn Markt, Produktion und Technologie zusammenspielen, wird aus einer funktionierenden Technologie eine industrielle Lösung.

Die Anwender-Sessions werden spezifischer

Ergänzend zu den Fertigungsthemen richtet die LOPEC Conference ihren Fokus verstärkt auf wichtige Anwendungsfelder. Zur nächsten Veranstaltung werden insbesondere die Branchen Healthcare sowie Defense, Security and Aerospace in speziellen Anwendersessions beleuchtet.

Die Bandbreite möglicher Anwendungen reicht von körpernaher Sensorik und intelligenten Textilien bis zu funktionalen Oberflächen. Dünne und flexible Komponenten können Mess-, Heiz- oder Lichtfunktionen übernehmen und sich an unterschiedliche Formen anpassen. Hier knüpfen die Anwender-Sessions an die technischen und wissenschaftlichen Sessions der Konferenz an.

Von Materialien bis zur Anwendung

Die LOPEC vereint Messe und Kongress unter einem Dach. Der Kongress vertieft die technologischen und wissenschaftlichen Fragestellungen, auf der Fachmesse werden die Lösungen konkret und erlebbar. Das Angebot reicht entlang der gesamten

Wertschöpfungskette: von funktionalen Materialien und Fertigungsanlagen über Bauelemente bis hin zur Systemintegration und fertigen Anwendung. Fachbesucher können so verschiedene Ansätze besser einordnen, Lösungen vergleichen und mit möglichen Entwicklungs- und Produktionspartnern ins Gespräch kommen.

Weitere Informationen gibt es unter lopec.com

LOPEC
Die LOPEC (Large-area, Organic & Printed Electronics Convention) ist die führende internationale Veranstaltung für gedruckte Elektronik. Die Kombination von Fachmesse und Konferenz bildet die Komplexität und Dynamik dieser jungen Industrie optimal ab. Die LOPEC wird von der OE-A und der Messe München GmbH gemeinsam organisiert. Die nächste Veranstaltung findet vom 2. bis 4. März 2027 im International Congress Center der Messe München statt.

Messe München
Als einer der bedeutendsten Messeveranstalter der Welt zeigt die Messe München auf ihren weltweit rund 90 Fachmessen die Welt von morgen. Darunter sind 14 Weltleitmessen wie bauma, BAU, IFAT oder electronica. Das Portfolio umfasst Fachmessen für Investitions- und Konsumgüter ebenso wie für neue Technologien. Zusammen mit ihren 1.300 Mitarbeitenden im Konzern und den Beteiligungsgesellschaften organisiert sie Fachmessen in China, Indien, Brasilien, Südafrika, Türkei, Singapur, Vietnam, Hongkong, Thailand und den USA. Mit einem internationalen Netzwerk von Beteiligungsgesellschaften und Auslandsvertretungen ist die Messe München weltweit aktiv. Die jährlich mehr als 150 Veranstaltungen ziehen im In- und Ausland rund 50.000 Aussteller und rund drei Millionen Besucher an. Damit ist die Messe München ein wichtiger Wirtschaftsmotor, der Kaufkrafteffekte in Milliardenhöhe auslöst.

OE-A – Advancing the Flexible and Printed Electronics Industry
Die OE-A ist der führende internationale Industrieverband für flexible, organische und gedruckte Elektronik. Sie repräsentiert die gesamte Wertschöpfungskette dieser Industrie. Mitglieder sind international führende Firmen und Einrichtungen von Forschungs- und Entwicklungs-Instituten, Maschinenbauern und Materialherstellern über Produzenten bis hin zu Endanwendern. 180 Firmen aus Europa, Asien, Nord-Amerika und Afrika arbeiten in der OE-A zusammen, um den Aufbau einer wettbewerbsfähigen Infrastruktur für die Produktion von flexibler und gedruckter Elektronik zu fördern. OE-A ist eine internationale Arbeitsgemeinschaft im VDMA. www.oe-a.org